DOC	UMENT No. KSH-701	TITLE		PRODUCT		IFICATIO	DNS		PAGE 1.77
				製品		株	=		1/7
BAC	KGROUND								
							•		
	eneral 一般事項						***************************************		
1.1	Application 適用的					ey switch	es which have no ke	y top.	
İ			ES:MECHANICA た、キートップ無しのシ			ッチ・メカニカ	ルコンタクト)について 遃	田する	
1.2	Operating temperature						al air pressure 常湿		
		Operating tempe	rature range sha	ll refer to the	e range w	here this	switch keeps electri	cal function within s	uch temperatures.
13	Storage temperature ra	使用温度範囲と1 nge 保存温度範囲:						1 ** == \	
	Test conditions 試験も						al air pressure 常温 g measurements and		•
		試験及び測定は	特に規定がない	限り以下の構	準状態の	もとで行	う。	. costo are as ronow	••
		Normal tem					5~35°C)		
		Normal hun Normal air :	•				25~85%) 6~106kPa{860~10	60mbarl)	
							he following condition		
			足義を生じた場合	_		行う。			
		Ambient te Relative hu		度: 20: 湿度: 60~7					
		Air pressur				[860 ~ 106	60mbar}		
			mounted on PWB	without any	/ indicatio				_
		スイッチは回路基本	反から浮かないよ	うに取り付け	ける。				
2. Ap	pearance, style and dim	ensions 外観、形状、寸流	去						
2.1	Appearance 外観					rviceabilit	y of the product.		
2.2 :	Style and dimensions		注有害な欠陥が the assembly dra						
			addenibly ura	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	#E⊒1~&@	0			
3. Ty	pe of actuating 動作形	式 <u>Tactile feedb</u>	<u> タクティ-</u>	ールフィード/	<u> </u>				
4. Co	ntact arrangement 🔲	路形式 _1_poles_1_t	hrows 1 i	回路 <u>1</u> 接点	i				
			contact arrange			assembly	drawings 回路0	D詳細は製品図によ	3)
	tings 定格 Maximum ratings 最大	字枚 10 ソワ	0 50 4						
	Minimum ratings 最小。		C <u>50</u> mA C 10 μA						
			,····						
t. Ele	ectrical specification 質 Items 項目	氢氧的性能	Test conditions		試験 条	. #		7 0:1	viest come view date
6.1	Contact resistance	Applying a below static lo					ts shall be made.	Criteria 100 mΩ Max	
	接触抵抗	スイッチ操作部中央に下記の	の静荷重を加え、	測定する。					
		(1) Depression (2) Measuring method 湯	押圧力: <u>3.2</u> 加定方法:1.44z		nt contac	t raciatan	oo matar ar valtara		
		(L) Moddaring metriod y		nethod at 5\			ce meter or voltage		
			1kHz 微	少電流接触技	低抗計, 3	ては DC5\	/ 10mA 電圧降下法		
6.2	Insulation resistance	Measurements shall be m 下記条件で試験を行った	ade following the 逐 瀬本士文	test set for	th below:			_100_MΩ Min.	
	絶縁抵抗		夜、冽足りる。 D電圧: <u>100</u> V	DC for 1 m	in.				
		(2) Applied position E				d if there	is a metal frame,	,	
	The second of th			en terminals 今間フローノ					ere ere ere og er og ere er
6.3	Voltage proof	Measurements shall be m				合は、場	子と金属フレーム間	71 1 11 1	
0.0	耐電圧	下記条件で試験を行った	ade following the 後、測定する。	test set for	tn below:			There shall be no b 絶縁破壊のないこ	
		(1) Test voltage 印	加電圧: <u>100</u>	V AC (50∼6	iOHz)				_•
		(2) Duration 印 (3) Applied position 印	加時間:1 min 加場所:Patusas	المسائسة الم	. AJ :E.	L			
		(3) Applied position Fp.		terminals ar			metai frame,	}	
			端子間,	金属フレーム	ムがあるり	骨は,端	子と金属フレーム間		
6.4		Lightly striking the center per s.), bounce shall be te			ntered in	normal us	se (3 to 4 operations	(ms Max.
	1 7	スイッチ操作部の中央部			∕秒)で軸	Yく打鍵し	, ON時及びOFF時	OFF bounce: 10	ms Max.
		のパウンスを測定する。	Switch			>			,
		_	Switch			_			
		. =	5V	5kΩ			cilloscope ノロスコープ		
		_		<		1.	/u/u/		
i						→			
			″on″ ∏ ∏	[ПП		FF"		
			1111						
				ا د	∐ 				
			$\left \longleftrightarrow\right>$	•	 <	\rightarrow			
					<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		DSGD. May. 19	20/0 ED3 DG1
								」 ∕₁ ′′∶	Ta
								W.	somoe
			++					CHKD. May 7	2010
							· .	20	Thur.
								APPD. May	19 2010
AGE	SYMB BACK	GROUND	DATE	APPD	 	CHKD	DSGD	17	there
			·				1		

OCUMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
KSH-701	製品仕様書	2/7
Mechanical specification	機械的性能	
Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
1 Operating force 作動力	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually increasing the load applied to the center of the projection, the maximum load required for the switch to come to a stop shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に徐々に荷重を加え、操作部が停止するまでの最大荷重を測定する。	1.6 ± 0.5 N
2 Travel 移動量	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then applying a static load to the center of the stem, the travel distance for the switch to come to a make "ON" shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に静荷重を加え、スイッチがONするまでの距離を測定する。	<u>0. 15 ± 0. 1 mm</u>
3 Return force 復帰力	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and,upon depression of the projection in its center the travel distance,the force of the projection to return tot its free position shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部を移動量押圧後、操作部が復帰する力を測定する。	O. 2 N Min.
4 Stop strength ストッパー強度	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then a below static load shall be applied in the direction of projection operation. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の静荷重を加える。 (1) Depression 押圧力: 30 N (2) Time 時間: 15 s	and electrically.
Environmental specification	on 耐候性能	
Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
1 Resistance to low temperatures 耐寒性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: <u>-40 ± 2</u> °C (2) Time 時間: <u>96 h</u> (3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Item 6. Item 7.1 Item 7.2
2 Heat resistance 耐熱性		Item 6. Item 7.1 Item 7.2
Moisture resistance 耐湿性	次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: <u>60</u> ± <u>2</u> ℃ (2) Time 時間: <u>96</u> h (3) Relative humidity 相対湿度: <u>90 ~ 95</u> % (4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1): <u>500</u> m Ω Max. Insulation resistance 絶報抵抗(Item 6.2): <u>10</u> M Ω Min. Item 6.3 Item 6.4 Item 7.1 Item 7.2
4 Change of temperature 温度サイクル	After below cycles of following conditions, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement shall be made. Water	Item 6.
	B	

DOC	IMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
	KSH-701	製品仕様書	3/7
			<u> </u>
9. End	lurance specification	耐久性能	
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
9.1	Operating life	Measurements shall be made following the test set forth below:	Contact resistance
	動作寿命	下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) _ 5 _ VDC _ 5 _ mA resistive load 抵抗負荷	接触抵抗(Item 6.1):_1_Ω Max. Insulation resistance
		(2) Rate of operation 動作速度: 2 to 3 operations per s 回/秒	絶縁抵抗(Item 6.2):10 _MΩ Min.
		(3) Depression 押圧力: <u>2.1</u> N Max.	Bounce バウンス(Item 6.4):
		(4)Cycles of operation 動作回数: <u>200, 000</u> cycles 回	ON bounce : 20 ms Max.
			OFF bounce: <u>20 m</u> s Max. Operating force 作動力(Item 7.1):
			$+30 \sim -30 \%$ of initial force
			初期値に対して
			Item 6.3 Item 7.2
9.2	Vibration		
3.2	resistance	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。	Item 6. Item 7.1
	耐振性	(1)Vibration frequency range 振動数範囲: 10~ 55 Hz	Item 7.2
		(2)Total amplitude 全振幅: 1.5 mm	4 . A
		(3)Sweep ratio 掃引の割合: <u>10 - 55 - 10</u> Hz Approx. <u>1 min</u> (4)Method of changing the sweep vibration frequency: Logarithmic or uniform	
		掃引振動数の変化方法 対数又は一様掃引	
		(5)Direction of vibration: Three mutually perpendicular directions,including the	direction
		振動の方向 of the travel スイッチ操作方向を中心とした垂直 3 方向	
		(6)Duration 振動時間: <u>2</u> h each (<u>6</u> h in total) 各 <u>2</u> 時間 (計 <u>6</u> B	時間)
9.3	Shock	Measurements shall be made following the test set forth below:	Item 6.
J.U	耐衝擊性	下記条件で試験を行った後、測定する。	Item 6.
		(1)Acceleration 加速度: <u>784</u> m/s²	Item 7.2
		(2)Test direction 試験方向: 6 directions 6 面 (3)Number of shocks 試験回数: 3 times per direction	
		(18_ times in total)	
		各方向各 <u>3</u> 回(計 <u>18</u> 回)	
		1	`
	•		
			•

DOCUMENT No. TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS PAGE 4/7 KSH-701 製品仕様書 10. Soldering conditions 半田付条件 Hand soldering Please practice according to below conditions. 手 半 田 以下の条件にて実施して下さい。 (1)Soldering temperature 半田温度: 350 °C Max. (2)Continuous soldering time 連続半田時間: <u>3</u> s Max. (3)Capacity of soldering iron 半田コテ容量: <u>20</u> W Max. (4)Excessive pressure shall not be applied to the terminal. 端子に異常加圧のないこと 10.2 Reflow soldering Please practice according to below conditions. リフロー半田 以下の条件にて実施して下さい。 (lead free solder) (鉛フリーはんだ用) Depending on reflow chamber used, the actual reflow condition might be slightly different. This may have a possibility to affect product. Please well-check the suitability with your reflow chamber in advance. リフロー槽の種類により、多少条件が異なるため製品に影響を及ぼす可能性があります。事前に十分確認の上使用して下さい。 Temperature on the Copper foil surface of PWB (°C) 基板銅箔面上温度(°C) 260°C Max. 3sec. Peak Temperature ピーク温度 180 150 Time 時間 120 sec.MAX. 40 s Max. (Pre-heating 予熱) 3 ~ 4 min.MAX. This inside soldering equipment 炉内通過時間 (1)Thickness of printed circuit board shall be 0.8 mm. 基板厚さは 0.8mm を推奨します。 (2) Times リフロー半田回数 : 2 times Max. 2回以内 Twice soldering would be reflow the temperature goes down to a normal temperature. 2回目を行う場合は、スイッチが常温に戻ってから行うこと。 10.3 Other precautions (1)Switch terminals and PWB. Upper face shall be free from flax prior to soldering. 事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。 For soldering 半田付けに関する (2) Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. その他注意事項 半田付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないで下さい。 (3) Recommended cream solder: M705-GRN360-K2-V(SENJU METAL INDUSTRY CO.,LTD) or equivalent 推奨クリーム半田: 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2-V 同等品 (4)The thickness of cream solder: 0.1~0.15mm クリーム半田印刷厚:0.1~0.15mm (5) When chip components is soldered on the back side of PWB by automatic flow soldering, after this switch soldered by reflow soldering, flux will possibly creep up at the exterior wall of the housing and penetrate into the housing due to flux ejection. Therefore, when the PWB is designed, please do not locate through holes adjacent to the switch mounted area. 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等によりスイッチ側面から フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたってはスイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないで下さい。 (6)As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be performed in the shortest period and at the lowest temperature possible. 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願いします。 (7)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side. スイッチの上面からフラックスが浸入しないようにして下さい。 (8)Recommended printed circuit board thickness is 0.8 mm. If you prefer to use flexible printed circuit (FPC), please put the same or more rigid board (ex. metal plate) under the FPC to support switch operation. 基板厚さは 0.8mm を推奨します。但しフレキシブル基板をご使用の際は、打鍵時の受けとして金属板等を設置し、同等の支持力が確保 出来る様ご配慮下さい。

DOCUMENT No. KSH701	TITLE	PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 5/7

【Precaution in use】ご使用上の注意

A. General 一般項目

A1. For the export of products which are controlled items subject to foreign and domestic export laws and regulations, you must obtain approval and/or follow the formalities of such laws and regulations.

国内外の輸出関連法規により規制されている製品の輸出に際しては、同法規を遵守の上、必要な許可、手続き等をとってください。

A2. Products must not be used for military and/or antisocial purposes such as terrorism, and shall not be supplied to any party intending to use the products for such purposes.

軍事用途又はテロ等の反社会活動目的では、当製品を一切使用しないでください。また、最終的にそれら用途・目的で使用されるおそれがある法人・団体・個人等へも当製品を一切供給しないでください。

A3. Unless provided otherwise, the products have been designed and manufactured for application to equipment and devices which are sold to end-users in the market, such as AV (audio visual) equipment, home electric equipment, office and commercial electronic equipment, information and communication equipment or amusement equipment. The products are not intended for use in, and must not be used for, any application of nuclear equipment, driving control equipment for aerospace or any other unauthorized use. With the exception of the above mentioned banned applications, for applications involving high levels of safety and liability such as medical equipment, burglar alarm equipment, disaster prevention equipment and undersea equipment, please contact an Alps sales representative and/or evaluate the total system on the applicability. Also, implement a fail—safe design, protection circuit, redundant circuit, malfunction protection and/or fire protection into the complete system for safety and reliability of the total system.

当製品は、特に用途を指定していないかぎり、本来、AV、家電、事務機、情報機器、通信機器、アミューズメント機器等の一般電子機器用に設計、製造されたものです。したがいまして、原子力制御機器、宇宙・航空機で運行にかかわる機器等の用途では一切使用しないでください。上記の使用禁止の用途以外で、医療機器、防犯機器、防災機器、海底用機器等の高度の安全性・信頼性を必要とする機器でのご使用の際は、弊社営業担当迄ご相談いただくか、またはセットでの十分な適合性の確認を行っていただいた上で、フェールセーフ設計、保護回路、冗長回路、誤動作防止設計、延焼対策設計等のセットでの安全対策設計を設けてください。

- A4. Before using products which were not specifically designed for use in automotive applications, please contact an Alps sales representative. 車載対応製品以外の製品を車載用にご使用される場合は、事前に弊社へご相談ください。
- A5. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.

本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L), 容量性負荷(C))で使用される場合は、別途ご相談ください。

- B. Soldering and assemble to PC board process 半田付, 基板実装工程
- B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。
- B2. Conditions of soldering shall be confirmed under actual production conditions.
 はんだ付けの条件の設定については、実際の量産条件で確認されるようお願いします。
- B3. If the switch is given stress from the side, it may result in damages to switch functions. Therefore please handle it with extreme care.

 When the switch is carried, any shock shall not be applied to the switch.

スイッチに横からの力が加わりますと、スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。 移動する場合はスイッチに衝撃が加わらない様に注意して下さい。

B4. As this switch is designed for reflow soldering, if you place it at the edge of PWB for convenience, then flux may get into the sliding part of the SW during automatic dip soldering after being mounted, so do not apply auto dip after being mounted.

当スイッチはリフロー半田対応ですが、スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが浸入する恐れが有りますので、十分にご注意下さい。

B5. Conditions for thermosetting oven. 熱硬化炉条件

When the board on which the switch is mounted has to be put in the oven so as to harden adhesive for other parts, the conditions shall be 160°C at max. (on the parts mounted side of PWB), and not longer than 2 minutes.

スイッチを取り付けた後,他の部品の接着剤硬化等のため熱硬化炉を通す場合,条件は160℃以下(基板部品面の温度),2分以内として下さい。

- B6. As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be done within the recommended conditions. 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので推奨半田条件以内で半田を行う様にお願いします。
- B7. Please be careful, especially when you use any other type of solder except recommended one. 推奨以外の半田をご使用の際は十分にご注意願います。
- B8. This switch is packaged in conductive emboss taping. In case that pwb mounting device does not have ESD ground protection, and/or pwb assembly under low humidity condition, our switch may have be negative influenced by ESD. Due to the above potential concerns, voltage proof to be set as no more than 100mV. 本スイッチのテーピング材料は導電性材料を使用していますが、基板実装工程において実装設備にアースが設けられていない場合や使用環境で湿度が低い場合スイッチが静電気による影響を受ける場合がございます。帯電圧は100mV以下となるようご考慮願います。
- B9. Switch shall be mounted and soldered on PWB without floating/gap between the bottom of switch and PWB.

 When such a floating/gap is significant, it may cause degradation in mechanical properties and operation life durability of switch.
 スイッチ底面と回路基板との間に隙間が生じないように取り付けてください。
 この隙間が大きいと機械的特性や耐久性を損ないますので、取り付けの際にはご注意をお願いします。
- B10. Switch may be attracted with a carrier tape and/or a cover tape due to static electricity charged on the surface, depending on the mounting environments. The following static-eliminating solutions shall be implemented, but not limited to; remove static electricity from a reel holder of assembly machine, or use an air ionizer in removing top tape from the carrier tape.

環境によって実装する際に、キャリアテープ又はカバーテープが静電気を帯びてスイッチがキャリアテープまたはカバーテープに貼り付いていることがありますので、カセッターなどの静電除去やカバーテープを剥がすと同時にイオン放射するなどの静電除去処理をするようお願いします。

- C. Washing process 洗浄工程
- C1. This switch shall not be cleaned up with solvents or like after soldering and/or touch-up soldering. 半田付け後及び手直し後に、溶剤などでスイッチを洗浄しないでください。

DOCUMENT No. KSH-701	TITLE	PRODUCT 製品		PAGE	6/7

- D. Mechanism design(switch layout) 機構設計
- D1. When users use a different PWB mounting hole and land footprints/pattern from our recommended dimensions, the prior consultation shall be made with us. プリント基板取り付け穴およびパターンに関し、推奨寸法以外を採用する場合は、当社に連絡願います。
- D2. You may dip-solder chip components on the backside of PWB after you have reflow-soldered this switch. However, dip-soldering may cause flux to creep up on the wall of the housing and penetrate the switch. Therefore, do not design a throughhole under and around the switch.

本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等により、スイッチ側面より、

フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては、スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないで下さい。

- D3. Do not push except the Actuating area. 操作位置以外を打鍵しないで下さい。
- D4. Dimensions of the tip of striking part. 打鍵部先端形状
 - ·As show in the sketch, set knob shall have ϕ 0.8 mm flat shape.
 - 右図に示す、608の円柱形状として下さい。
 - •Please set knob to flat shape of ϕ 0.65 mm or more.
 - φ0.65 以上の円柱形状として下さい。
 - ·If the switch is pushed by other shapes, the trouble of the feeling deterioration, etc. might occur. 他の形状で打鍵した場合、フィーリング悪化等の不具合が発生する恐れがあります。
- D5. Operating Conditions. 操作条件
 - Deviation of striking part from the center axis of the switch shall be within 0.35mm.

スイッチ外形を基準とする中心軸線よりの、打鍵部ズレは 0.35mm 以下にて御使用下さい。

- ·Allowable inclination of keying section : 90±2 degrees or less.
- 打鍵部中心軸線の傾きは、90±2度以内に設定して下さい。
- Operating force and click ratio will vary according to the amount of offset, so we recommend you to minimize the amount of offset.

(This is not to guarantee mechanical specification.)

スイッチ中心から外れると特性変化の要因になりますので、出来るだけズレ量を抑えるよう推奨致します。 (機械的特性を保証するものではありません)。

D6. Sealing film on use the switch shall be free from damages by sharp edged objects. スイッチのフィルム部分を鋭利なもので押さえることは避けて下さい。

D7. This switch is designed for unit construction that it is pressed by human operation.

It is not possible to use this switch as a mechanism detection function.

In case such detecting function is required, please consult with our detector switch section.

当スイッチは、直接人の操作を介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。

メカ的な検出機能としてのご使用は出来ません。

検出機能には弊社検出スイッチをご使用下さい。

D8. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the stopper.)

スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。 (ストッパー強度参照)

- D9. If you intend to change the way of the switch being used on your module, please let us know. セット上でのスイッチの使われ方が変更される際は当社に御連絡ください。
- D10. Designing printed pattern and parts layout shall be condidered becance the characteristics may change due to warp of PWB. 基板のソリによって特性が変化する場合がありますので、パターン設計・レイアウトについては十分考慮願います。
- D11. This switch shall not be pressed and/or operated at any impact force. When switch is pressed at impact force, this may potentially cause damage or breakage of switch.

スイッチ操作時に衝撃を与えないで下さい。衝撃が加わりますとスイッチが破損する危険性があります。

D12. This switch is not designed for keeping pressed down for a certain duration of time. If users intend to use our switch for such purpose, they shall verify such suitability With the own actual samples in advance as well as shall use for this purpose under sole responsibility. The prior consultation with us is also needed.

本製品は長押しする用途で設計されたものではありません。本製品を長押し使用される場合は当社にご連絡いただき、仕様内容を調整した上で採用可否判断願います。

E. Using environment 使用環境

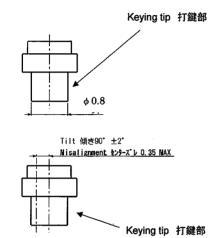
E1. In case this product is always used around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated or in a place where exhaust gas from automobiles exists, take most care due to the switch performance might be affected.

硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので十分にご 注意下さい。

E2. Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed.

同一セット内に以下の様な部材に関しましては以下の点にご注意願います。

- For parts, rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.
- 部品、ゴム材料、接着剤、合板、機器の梱包材、機器内の駆動部に使用される潤滑剤については、硫化、酸化ガスを発生しないものを採用してください。
- ·When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecula siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure.
- シリコン系ゴム、グリース、接着剤、オイルを使用される場合は、低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。低分子シロキサンガスが発生しますと SW接点部に2酸化珪素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。
- ·When you apply chemical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand. 製品のコーティング剤等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談ください。



KSH-701	製品仕様書	7/7
	The state of the s	
Do not use this switch in the atmosphere wit	h high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may	

F1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures. However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass.

製品は納入形態のまま常温,常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用ください。

F2. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible.

開封後はポリフクロで外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。

F3. Do not stack too many switches for strafe.

過剰な積み重ねは行わないで下さい。

- F4. Keyswitches shall be kept as released position, when they are stored. スイッチの操作部を押し切ったままでの保存はしないでください。
- G. Others. その他
- G1. This specification will be invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order. 本仕様書は発行日より1 年間を経過して、ご返却又はご発注の無い場合は、無効とさせていただきます。
- G2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own discretion. 電気的. 機械的特性. 外観寸法および取付寸法以外につきましては、当社の都合により変更させて頂く事が有りますので、あらかじめ御了承下さい。
- G3. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current. 定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策を
 - 定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策を して下さい。
- G4. The flammability grade of the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain from using it in the place where it can catch fire, or take measures to preclude catching fire.

 本製品に使用している樹脂等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。 つきましては類焼の恐れがある場所での使用を禁止するか、類焼防止対策をお願いします。
- G5. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring higher safety, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch in case the switch alone should fail. And securesafety as a whole system by introducing the fail-safe design, i.e. a protection network. スイッチの品質には万全を尽くしていますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、スイッチの単品故障にたいしてセットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路、等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますようにお願いします。
- G6. TACT Switch is trademark or registered trademark of ALPS ELECTRIC CO.,LTD.. タクトスイッチはアルプス電気株式会社の商標もしくは登録商標です。

